

苏州国芯科技股份有限公司

2023年11月23日-24日投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2023-023

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	中信保诚基金；财通基金；东北证券。
时间	2023年11月23日 15:00 2023年11月24日 10:00
地点	线上交流
上市公司参加人员姓名	董事会秘书：黄涛先生； 证券事务代表：龚小刚先生；
投资者关系活动主要内容介绍	<p>说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。</p> <p>1、汽车电子领域去库存的进展怎么样？</p> <p>答：今年以来，由于模组厂、主机厂在“缺芯”阶段对于汽车电子芯片的库存较多，需求相对不足，这对公司汽车电子业务的业绩短期内造成一定影响。进入今年四季度以来，通过公司与产业链上下游的客户沟通交流情况来看，去库存已进入一个加速的阶段，库存端压力相对减少，下游终端需求逐步改善，虽需求短期内较难出现大幅度修复，但是预计将保持逐季改善的趋势。</p> <p>2、公司持续加大研发投入的原因什么？对于未来的研发投入是怎么规划的？</p> <p>答：公司在2023年1月至9月的研发投入为177,529,218.72元，</p>

	<p>比上年同期增长 99.24%；前三季度研发投入占收入的比例为 47.30%，同比增加 19.66 个百分点。基于公司的发展战略，为抓住汽车电子、高性能计算和 AI 领域的发展机遇，特别是进一步抓住汽车电子国产替代的发展窗口期，公司持续加大了研发投入，大幅度地增加了研发人员数量，大力布局汽车电子、RAID 控制芯片、云安全芯片等自主芯片的研发。未来，公司将会持续致力于对前述重点业务领域芯片产品实现系列化的开发和应用，满足客户的需要。</p> <p>3、公司研发的面向高端座舱音频处理的 DSP 芯片—CCD5001 的应用场景有哪些？未来是否计划开发系列化产品打开更广泛的市场？</p> <p>答：针对新能源汽车市场，为满足乘用车供应商和主机厂对座舱音频系统升级的紧迫需求，公司于近日成功研发了一款面向高端座舱音频处理的 DSP 芯片—CCD5001，该芯片产品是基于 HIFI5 架构内核研发的高性能 DSP 芯片，专为车载平台的有源噪声控制、高阶环绕音效、智能语音交互等应用场景而设计，芯片在满足极低时延、高浮点性能和多通道信号处理需求的同时，也可广泛应用于工业、交通等领域，满足高可靠性的信号处理或实时控制需求。</p> <p>随着高端 DSP 芯片产品 CCD5001 的亮相，国芯科技也在积极布局未来的 DSP 系列芯片群。通过深入研究不同车型音频处理需求，对比国外 DSP 产品综合性能和成本，公司未来将推出全新 DSP 芯片家族，包括已经推出的高端产品 CCD5001，以及适用于进阶应用的 CCD4001 和基础应用的 CCD3001，按照汽车电子 Grade2 等级开发和生产，具备高可靠性和高安全性，可以应用于汽车及工业等环境条件苛刻的使用场景，从而增加了产品的应用覆盖面，力争取得较强的性价比竞争优势。</p>
附件清单（如有）	无

日期	2023 年 11 月
----	-------------